

产品湿敏等级定义

艾为产品湿敏等级分类遵循 IPC/JEDEC J-STD-020 标准:

水平 level	室内贮存		试验的必要条件			
	时间	条件	标准试验		相当的加速试验	
			时间 (小时)	条件	时间 (小时)	条件
1	无限制	≤30℃/85%RH	168 +5/-0	85℃/85%RH	—	—
2	1年	≤30℃/60%RH	168 +5/-0	85℃/60%RH	—	—
2a	4周	≤30℃/60%RH	696 +5/-0	30℃/60%RH	120 +1/-0	60℃/60%RH
3	168小时	≤30℃/60%RH	192 +5/-0	30℃/60%RH	40 +1/-0	60℃/60%RH
4	72小时	≤30℃/60%RH	96 +2/-0	30℃/60%RH	20 +0.5/-0	60℃/60%RH
5	48小时	≤30℃/60%RH	72 +2/-0	30℃/60%RH	15 +0.5/-0	60℃/60%RH
5a	24小时	≤30℃/60%RH	48 +2/-0	30℃/60%RH	10 +0.5/-0	60℃/60%RH
6	标签时间	≤30℃/60%RH	标签时间	30℃/60%RH	—	—

* 湿度敏感等级 MSL (Moisture Sensitivity Level), 由小排到大, 数字越小的表示其抗湿度能力越好; 数字越大的, 表示其可以暴露于环境湿气的的时间越短。

* 以 MSL 等级 3 (level 3)来举例说明, 如果芯片暴露在 30℃与 60%湿度以内的环境下, 那么其存放时间就不可以超过 168 小时, 也就是说对于等级 3 的芯片从真空包装中取出后, 就必须在 168 个小时内 SMT 贴片并完成回流焊。

艾为产品湿敏等级标签标示如下(绿色方框标出):

